



Kompaktdosiersystem C-DS

Anpassungsfähig – vom Handarbeitsplatz bis zur vollautomatisierten Roboteranlage

Kompaktes Dosiersystem für alle Dosieraufgaben

Alle RAMPF-Mischsysteme einsetzbar. Für alle Automationslösungen geeignetes Misch- und Dosiersystem.



Kompakter Aufbau

- Gemeinsames Maschinengestell für Steuerung und Materialaufbereitung, auch in verkleideter Ausführung



Hohe Flexibilität

- Dosierpumpen und Mischsystem individuell in vorhandene Handlingsysteme integrierbar
- Alle RAMPF Dosier- und Mischsysteme (dynamisch und statisch) einsetzbar



Digital und intuitiv

- Steuerung: Siemens oder Beckhoff
- Schnittstelle zu übergeordneten Steuerungssystemen (MES)
- Monitoring: Permanente Überwachung der Prozessparameter: u. a. Drücke, Temperaturen und Füllstände
- RAMPF-HMI für eine einheitliche Bedienoberfläche

C-DS in Aktion
beim Dichtungs-
auftrag



Dosiertechnologie und Digitalisierung von RAMPF

Das neue HMI

- Eine einheitliche Bedienoberfläche für Dosierprozess und Steuerung der CNC-Achsen
- Volle Integration von Automatisierungs- und Prüftechnik
- Hardware-unabhängige Lösung mit verfahrensbezogenen Icons und intuitiver Menüführung (Touch)
- Zugriff auf das System durch mobile Endgeräte
- Hardware von Beckhoff oder Siemens einsetzbar
- Visualisierung prozessrelevanter Parameter übersichtliche grafische Menüführung
- Service-Support-Tool



Dosierübersicht



NC-Achsbewegungen



Drucküberwachung



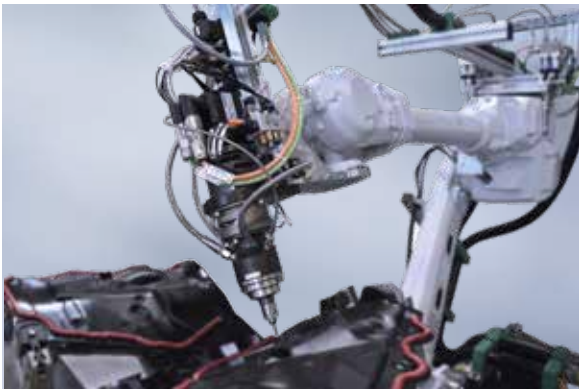
Produktionsdaten



Standard-C-DS
mit Materialaufbereitung,
Steuerung, Mischsystem
und Dosierkopf

Kompaktdosiersystem C-DS

Integrationsbeispiele



C-DS+R mit Roboter
für Materialauftrag auf komplexe 3D-Konturen



**C-DS+RA mit Roboter und
Automatisierungseinrichtung**
zur Integration in einen getakteten Fertigungsablauf

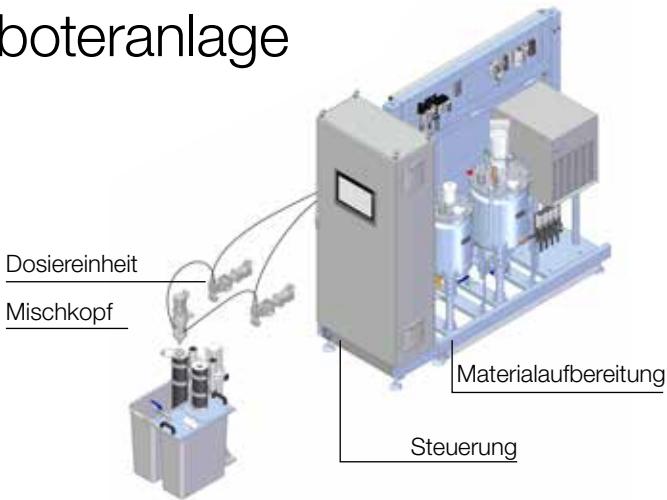


C-DS+RA mit Roboter und Transportband
Dosieranwendung integriert in einen Bauteilfluss über
Transportbandsystem

Für alle Dosieraufgaben vom Handarbeitsplatz bis zur vollautomatisierten Roboteranlage

Produktdetails

Das kompakte Dosiersystem C-DS ist ausgelegt zur Verarbeitung von ein- und zweikomponentigen Klebstoffen, Vergussmassen und Dichtmaterialien. Es eignet sich besonders zum Anbau an vorhandene Handlingsysteme (Linearachsen, Roboter) und verfügt außerdem über alle Ausstattungsmerkmale zum Verarbeiten von 2K-Dichtungsschaum. Das Dosiersystem besteht aus Materialaufbereitung, Dosierung, Mischsystem und Steuerung. Der modulare Aufbau macht eine Integration in vorhandene Fertigungslinien besonders einfach.



Technische Daten

Dosierleistung, Mischungsverhältnis, Anzahl Komponenten, etc. sind abhängig vom eingesetzten Mischsystem

Anzahl Materialkomponenten	1– 4
Dosierpumpe	Zahnrad- oder Kolbendosierpumpe
Mischsysteme	statisch und dynamisch
Steuerung	Siemens oder Beckhoff
Dosierparameter	frei programmierbar
Mensch-Maschine-Schnittstelle	HMI oder RAMPF-HMI
Schnittstellen	alle marktgängigen Schnittstellen

Optionen (weitere auf Anfrage)

- Hochdruck-Spülsystem mit Reiniger oder Wasser
- Luftbeladungseinrichtung mit Luftbeladungsregler
- Umpumpstation mit Rührwerk
- Dünnschichtentgasung für blasenfreien Verguss
- Materialrezirkulation
- Behälterrührwerk
- Servoangetriebene Linearachsen
- Prozessüberwachung
- Profibus- / Profinetanbindung
- Bedienpanel
- Temperierungssystem
- Ferndiagnose über Online-Zugang
- Barcode Scanner

RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG

Römerallee 14 | 78658 Zimmern o. R. | Deutschland
T +49.741.2902-0
E production.systems@rampf-group.com
www.rampf-group.com